



LEXCM^{CF}

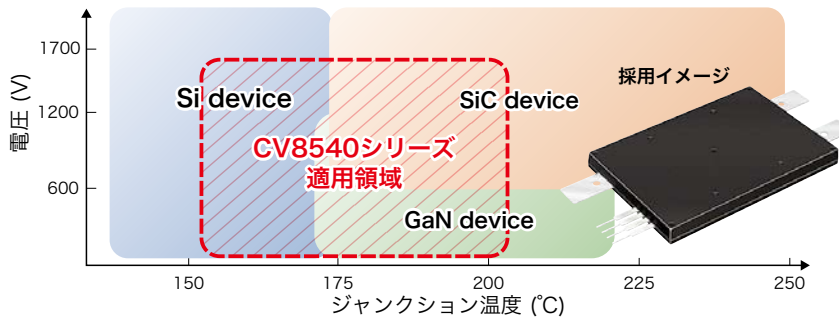
CV8540 series

パワーデバイス用 高耐熱半導体封止材

新規エポキシ樹脂システムの採用によって優れた耐熱性を持ち、次世代パワーデバイス (SiC, GaN) にも対応します。高温環境下におけるパワーモジュールの性能・信頼性向上に貢献します。

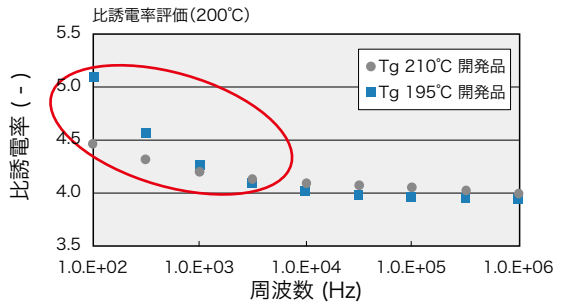
用途
半導体パッケージ/オートモーティブ
産業・車載インバータなどで使用されるパワーデバイス

コンセプト



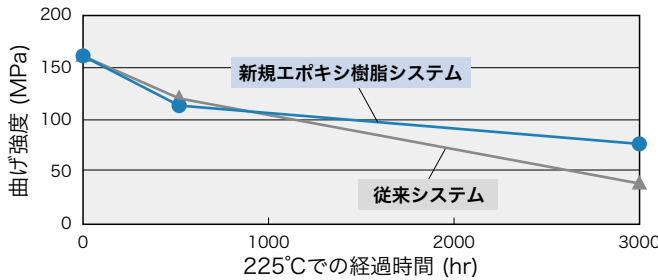
誘電特性 (Tg依存性)

高温低誘電率、低誘電正接に有効

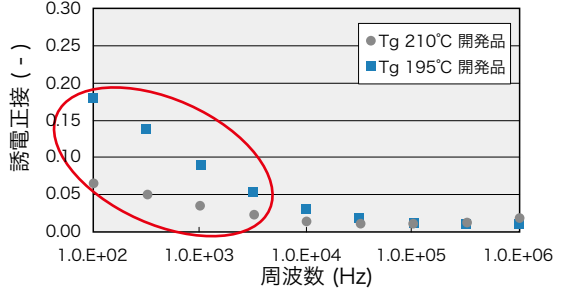


高耐熱性

曲げ強度の変化 (225°C放置時)



誘電正接評価 (200°C)



一般特性

項目	単位	LEXCM ^{CF} CV8540 series
ガラス転移温度 Tg (TMA)	°C	185-205
熱膨張係数 (CTE 1)	ppm/°C	11-13
熱膨張係数 (CTE 2)		48
曲げ強度 (25°C)	MPa	130-160
曲げ弾性率 (25°C)	GPa	15-19
耐燃性 (UL-94)	-	V-0
成形収縮率	%	0.25-0.4
ゲル化タイム	秒	30-40

商品のご採用にあたっては、当社webサイトより注意事項をご確認ください。

上記データは当社測定による代表値であり、保証値ではありません。

industrial.panasonic.com/jp/electronic-materials

パナソニック インダストリー株式会社 電子材料事業部

Panasonic Industry CV8540

© Panasonic Industry Co., Ltd. 202307